

19	課題番号	研究課題名	研究代表者	評価結果
	15106006	三次元積層型プロセッサチップを用いた超高性能並列処理システム	小柳 光正 (東北大学・大学院工学研究科・教授)	B
<p>(意見等)</p> <p>本プロジェクトの意義は大きく、現在の集積回路の多くの課題を解決するものであり、大きな波及効果も期待される。また、この2年間に得られた成果はほぼ計画に沿っていると思われる。</p> <p>しかしながら、当初の計画と今後の3年間の研究遂行計画を考えると、定量的な数値目標設定が良く見えない。実用化に向けた性能目標をしっかりと提示し、目標達成への必要条件を整えることが求められる。特に、要素技術からシステム技術へ移行する中での具体的技術を提示すべきである。また速度性能やばらつきなど実用化レベルでの技術開発が要請される。目標達成へのより一層の対応と努力が求められる。さらに、中途でのメンバー交代はやむをえないが、今後それを補う対応をする必要がある。</p>				
20	課題番号	研究課題名	研究代表者	評価結果
	15106007	チップ間無線通信を用いた高認知度処理システムの三次元集積アーキテクチャ	岩田 穆 (広島大学・大学院先端物質科学研究科・教授)	A
<p>(意見等)</p> <p>本プロジェクトは技術レベルの高いグループの研究であり、現在のところ計画通りの進捗状況であり、また研究成果の目標達成は可能と考えられる。また、その学術的価値は高く波及効果も大きい。</p> <p>しかしながら、当初からの達成度の定量的数値目標がはっきりしないことが課題であり、今後研究進展の中で、その提示と具体的対応項目との関連を示すべきである。さらに、電磁波干渉問題など多くの問題を解決し、実用化に向けての技術レベルを高めてほしい。</p>				